

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年4月15日(2021.4.15)

【公開番号】特開2019-87604(P2019-87604A)

【公開日】令和1年6月6日(2019.6.6)

【年通号数】公開・登録公報2019-021

【出願番号】特願2017-213724(P2017-213724)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 23 K 26/53 (2014.01)

H 01 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/78 Q

H 01 L 21/78 B

H 01 L 21/78 M

H 01 L 21/78 V

H 01 L 21/304 6 2 2 J

H 01 L 21/304 6 2 1 D

H 01 L 21/304 6 3 1

B 23 K 26/53

H 01 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】令和3年3月2日(2021.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ウェーハの表面にバックグランドテープを貼着するテープ貼着工程であって、前記ウェーハの表面に形成されたチップのバンプが、前記バックグランドテープの糊層に埋設されるテープ貼着工程と、

切断ラインに沿って前記ウェーハの裏面からレーザー光を入射して前記ウェーハの内部に改質領域を形成する改質領域形成工程と、

前記改質領域が形成された前記ウェーハに対し、前記ウェーハの裏面を加工することにより前記ウェーハの厚さを薄くする裏面加工工程と、

前記ウェーハの表面に前記バックグランドテープを貼着した状態で、前記ウェーハの裏面から前記切断ラインに荷重を加えて、前記ウェーハを前記切断ラインに沿って分割することにより前記ウェーハを個々のチップに分割する分割工程と、

を有するウェーハの加工方法。

【請求項2】

前記バックグランドテープは、基材と中間層と前記糊層とが順に積層されて構成され、前記糊層が前記ウェーハの表面に貼付される、

請求項1に記載のウェーハの加工方法。

【請求項3】

前記裏面加工工程は、

前記ウェーハの裏面を研削する研削工程と、  
前記研削工程後の前記ウェーハの裏面を化学機械的に研磨する研磨工程と、  
を有する請求項1又は2に記載のウェーハの加工方法。